

株主の皆さまへ

第 35 期 報 告 書

2012年4月1日から2013年3月31日まで



## 株主の皆さまへ

### ご挨拶

平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。ここに、当社第35期報告書（2012年4月1日から2013年3月31日まで）をお届けし、事業の概況等についてご報告申し上げます。

当連結会計年度におけるわが国経済は、復興需要による景気回復が期待される中で始まりました。

しかしながら、長引く欧州の債務問題や国内の電力需給問題、円高や政治イベントによる心理的な影響等により、前半の景況感は停滞、あるいはやや減速と言える水準となりました。

後半に入りますと、金融緩和観測の広がりから為替相場が急激に円安方向へと動き、輸出企業各社の業績回復が顕著となり、株式市場も上昇基調へと転じるなど様々な好影響があらわれました。

半導体業界におきましては、日本の半導体メーカーが外資の出資受け入れや、公的機関の支援を受けるなどの苦境にある中、生産設備を持たない半導体メーカー、いわゆるファブレス企業が半導体売上高で上位に入り、ますますその存在感を高めました。

また、依然として絶大な影響力を持つ世界トップのIDMやファウンドリーは、大手製造装置メーカーに資本参加し、次世代技術の開発に向けた取り組みを始めるとともに、技術力・資金力による優勝劣敗の構図が鮮明となりました。LED市場においては、照明用途がバックライト向けを上回り、引き続き順調に市場規模を拡大しました。

この様な状況のもと当社グループは、前連結会計年度に開催しましたプライベートショー（2011年12月）にご来場いただいたお客さまへの徹底的フォロー等によって、受注高に結び付けてまいりました。また、次世代の半導体パッケージに対応できる製造装置の開発にも注力し、顆粒樹脂を用いた樹脂流動の無いコンプレッション方式の成形プロセスをベースに、大面積ワークや高密度パッケージングに対しても信頼性の高いモールドングプロセスを提供できるよう取り組んでまいりました。

当社は、株主の皆さまへの利益還元を重要な経営施策の一つと考えており、競争力のある製品開発や生産設備への投資、さらなる財務体質の改善等に必要の内部留保を確保した上で、各事業年度の業績に応じた利益配分を実施することを基本方針としております。

この方針に基づき、当期につきましては、1株当たり10円の配当源資が可能となりました。

今後とも、株主の皆さまのご期待にお応えいたすべく、グループ一丸となって企業価値の向上に取り組んでまいりたく、何卒引き続き倍旧のご支援、ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。



代表取締役社長

代表取締役会長

岡田博和 飯永和彦

## 第35期の概況と今後の課題

当社グループは、財務・収益構造の改革を遂行し、損益分岐点売上高の引き下げを実現したことから、中期経営計画の2年目となる当事業年度に新体制を発足させ、攻めの経営へと大きく舵を切りました。一方、今後も世界経済や半導体市場の変動、当社グループの事業領域における新たな競合の発生など、様々な変化が起こることを前提とした上で、成長を続ける企業となるために必要な仕組みを構築するべく諸施策に取り組んでおります。

当連結会計年度の業績は、半導体市場が今ひとつの状況にあり、下半期には後工程製造装置に対する投資が極端に縮小する中、コンプレッション方式のモールドング装置が牽引役となり、売上高は164億54百万円（前連結会計年度比6億86百万円、4.0%減）と前期比微減に留まりました。また、第4四半期連結会計期間に大きく為替相場が変動（円安）したことから、連結決算処理における当社と子会社間の売上・仕入に係る未実現取引が増加し、連結業績の売上総利益が引き下げられる一方、当該未実現取引は営業外収益（為替差益）として戻し入れし、経常利益では影響を受けないことから、営業利益は4億39百万円の損失（前連結会計年度は14億76百万円の利益）となりますが、経常利益は6億63百万円（前連結会計年度比10億9百万円、60.3%減）、当期純利益は6億91百万円（前連結会計年度比2億76百万円、28.6%減）となりました。

### 京都駅ビルアート広告

#### —「真価に挑む、世界へ」—

京都駅ビル室町小路広場（京都駅ビル5階）と新幹線京都駅博多方面エスカレーターに、「真価に挑む」アート広告を掲出いたしました。

伝統と宗教都市としての古都京都を象徴する世界遺産、醍醐寺の至宝である五大力尊像と、文化・芸術都市としての京都を表現した躍動感あふれる墨書が、「京都は歴史への門である」を設計趣旨とする京都駅ビルに掲げられています。



名神高速道路京都南インターチェンジから京都市街地への玄関口となるTOWA本社のグランドスクリーンに続き、鉄道での玄関口となる京都駅のアート広告により、訪れる皆さまに京都の魅力と「原点に回帰し、ものづくり企業の真価に挑む」TOWAの強い決意を発信しつづけてまいります。

2013年6月



## 「お客さまのより近くで」 — グローバルな事業活動を強化 —

半導体業界ではファブレス企業が躍進し、大手のファウンドリー、アッセンブリーハウスがさらに存在感を増す等、いわゆる「水平分業」が加速しております。当社を含めた半導体製造装置メーカーにおいては、台湾や中国等のOSAT各社から量産装置・金型等の受注を得る営業活動はもちろん、半導体パッケージの開発段階における技術情報や試作・評価への確に対応し、量産時にコストダウンを実現する製造装置に必要な要素技術の開発を先行させておくことが重要となっております。

この様な環境に応じて当社グループは、既にアジア、北米、欧州等に事業拠点を展開しておりますが、有力なファブレス企業やOSAT各社のより近くで技術営業を展開し、さらにグローバルな事業活動を強化するため、北米拠点に半導体・LEDの成形実験等が行える試作ラボを設置しました。また、韓国地域では、半導体IDMとしてはもちろん、ファウンドリーとしても躍進する大手メーカーに対して万全のサポートが行える体制を整え、また、OSATが集中する台湾地域でも、当社グループの営業・サービス網を強化しております。

### 北米

ファブレス企業、デザインハウス等が集中するシリコンバレー。次世代の半導体はここから最先端の情報が発信されます。当社グループは、この北米拠点に半導体・LEDの成形実験等が行える試作ラボを設置し、半導体パッケージの開発段階で、モールドング技術によるソリューションを展開しています。

### 韓国

生産事業会社（株式会社東進）への出資比率を高め、金型製造工場として生産能力・設計技術力の増強を図っております。また、販売事業会社を新規に設立（TOWA韓国株式会社）し、韓国内に於ける製販一体となった事業活動が可能となりました。



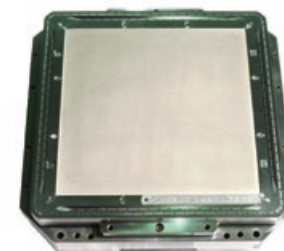
### 台湾

当社の主要なお客さまが集中する台湾地域において、パーツ販売およびアフターサービスを行っている「巨東精技股份有限公司」に追加資本を投入し、人的・物的な経営資源を強化しております。これにより、当社のお客さまのニーズにスピーディーに対応することが可能となり、さらにそのご満足度を高めてまいります。

## 最先端の半導体パッケージをコンプレッション技術で実現

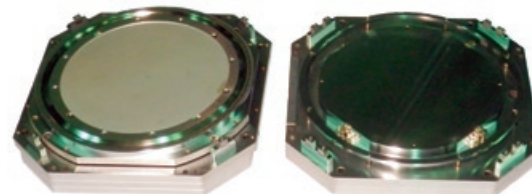
スマートフォンやタブレット端末に代表される電子機器の小型化、高性能化、そして低価格化は、半導体の進化によって成し得たものとも言えます。当社の独自技術であるコンプレッション技術は、多積載・高密度パッケージなど難易度の高い半導体のモールドング（封止）を可能にする“ブレイクスルー”となり、半導体製造工程に“イノベーション”を起こしました。

従来では成形が不可能と考えられていた超大型の基板やFOWLP（Fan Out Wafer Level Package）など次世代の半導体も、このコンプレッション技術によって実現が可能となりました。



▲300mm角のパネルモールド用金型

半導体からLED、車載製品など、コンプレッション技術は様々な躍進の可能性を齎す源泉となっております。



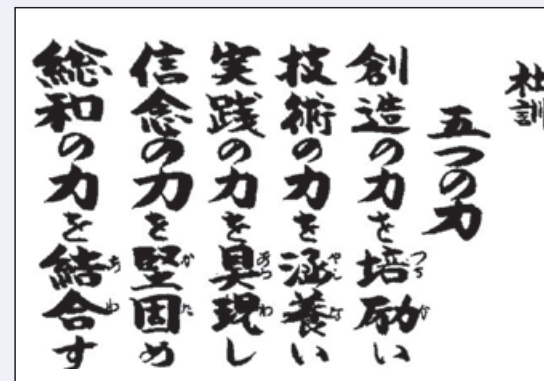
◀ ø12インチサイズの Wafer Level Package用金型

## TOWAの社訓

当社は、1979年4月17日に東和精密工業株式会社として設立し、創業にあわせて「五つの力」を社訓として掲げました。

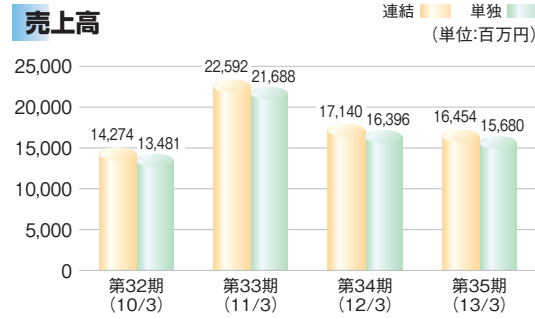
「ものづくり」への熱い想いと社訓「五つの力」を胸に刻み、株主さまをはじめとするステークホルダーの方々やお客さまに一層の信頼とご満足をいただけるよう、企業価値の向上に努めてまいります。

- ・創造の力を<sup>つちか</sup>培励い  
結果に対し、常に省みてよりよいものを創り出す
- ・技術の力を<sup>やしな</sup>涵養い  
日頃の練磨と研鑽が技術を育てる
- ・実践の力を<sup>あらわ</sup>具現し  
実行の力はすべてに勝る、率先垂範
- ・信念の力を<sup>かた</sup>堅固め  
自己を、そして他を強くする生きた信条をもつ
- ・総和の力を<sup>あわ</sup>結合す  
叡智を集めて社の発展に心を合わせる

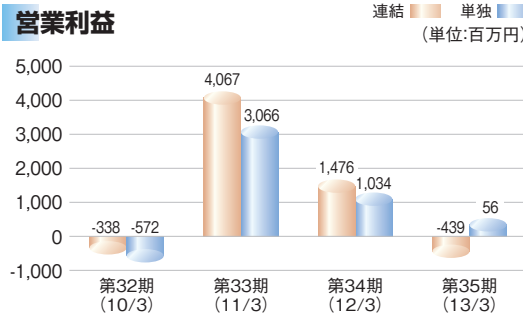


# 業績の推移

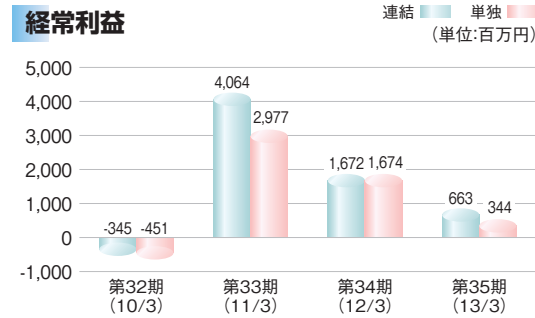
## 売上高



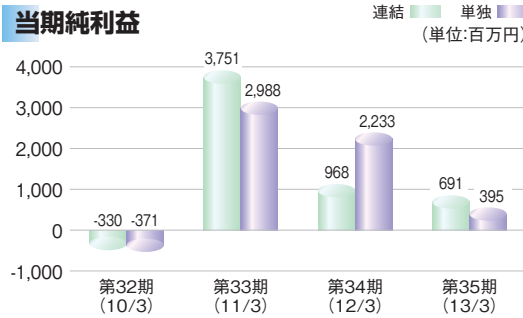
## 営業利益



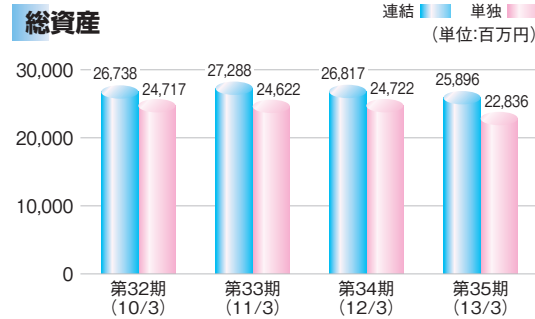
## 経常利益



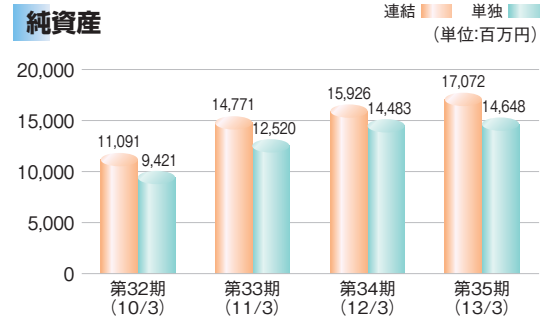
## 当期純利益



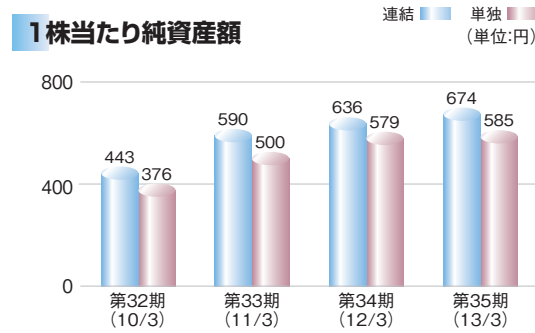
## 総資産



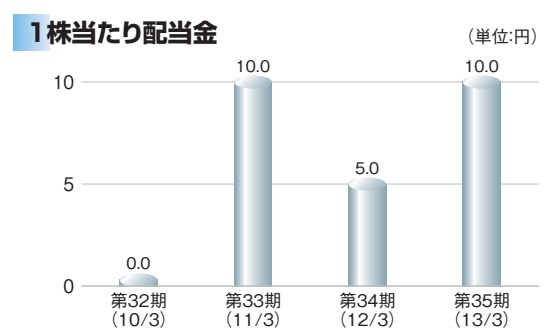
## 純資産



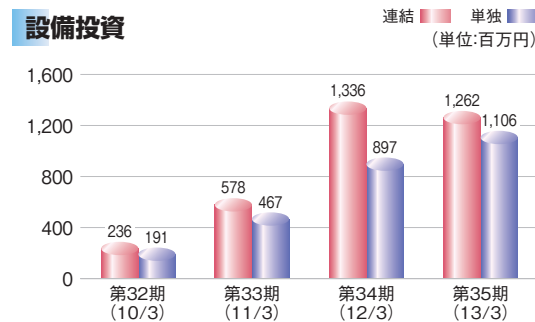
## 1株当たり純資産額



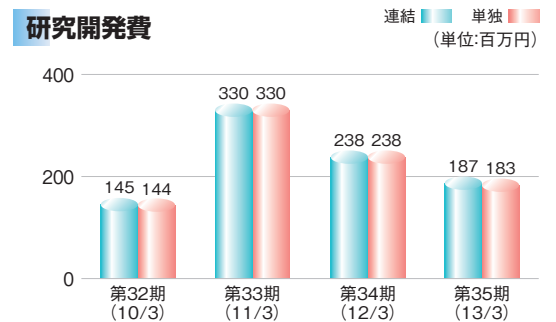
## 1株当たり配当金



## 設備投資

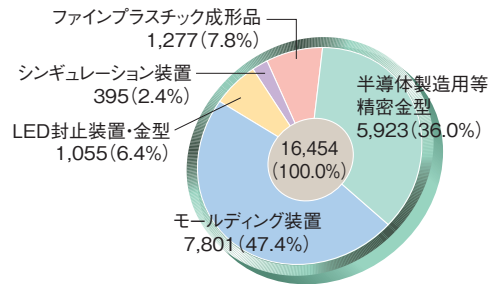


## 研究開発費

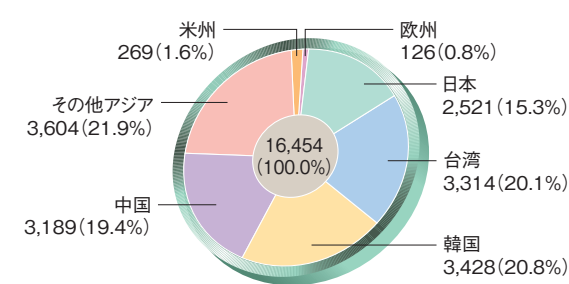


## [セグメント別連結売上高 (第35期)]

### ■製品別 (単位:百万円)



### ■地域別 (単位:百万円)



## 決算概要

連結貸借対照表 (2013年3月31日現在)

(単位：百万円)

科目	金額
<b>【資産の部】</b>	
流動資産	13,012
現金および預金	5,608
受取手形および売掛金	3,811
たな卸資産	3,293
その他	300
固定資産	12,884
有形固定資産	10,216
建物および構築物	3,684
土地	4,214
その他	2,318
無形固定資産	632
投資その他の資産	2,035
資産合計	25,896

(注) 当期の連結子会社は12社、持分法適用会社は2社であります。

連結損益計算書

(2012年4月1日から2013年3月31日まで)

(単位：百万円)

科目	金額
売上高	16,454
売上原価	12,696
売上総利益	3,757
販売費および一般管理費	4,197
営業損失	439
営業外収益	1,248
営業外費用	146
経常利益	663
特別利益	112
特別損失	15
税金等調整前当期純利益	759
法人税・住民税および事業税	90
法人税等調整額	△ 14
少数株主損益調整前当期純利益	683
少数株主損失	7
当期純利益	691

科目	金額
<b>【負債および純資産の部】</b>	
流動負債	4,982
支払手形および買掛金	1,337
短期借入金	1,068
その他	2,577
固定負債	3,841
長期借入金	2,539
その他	1,302
負債合計	8,824
株主資本	16,276
資本金	8,932
資本剰余金	462
利益剰余金	6,890
自己株式	△ 8
その他の包括利益累計額	595
その他有価証券評価差額金	392
為替換算調整勘定	202
少数株主持分	200
純資産合計	17,072
負債・純資産合計	25,896

連結キャッシュ・フロー計算書

(2012年4月1日から2013年3月31日まで)

(単位：百万円)

科目	金額
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,710
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,083
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 817
現金および現金同等物に係る換算差額	62
現金および現金同等物の増減額	871
現金および現金同等物の期首残高	4,395
現金および現金同等物の期末残高	5,266

連結株主資本等変動計算書 (2012年4月1日から2013年3月31日まで)

(単位：百万円)

	株主資本				
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計
2012年4月1日 期首残高	8,932	462	6,324	△ 8	15,710
連結会計年度中の変動額					
剰余金の配当			△ 125		△ 125
当期純利益			691		691
自己株式の取得				△ 0	△ 0
株主資本以外の項目の連結会計年度中の変動額(純額)					
連結会計年度中の変動額合計	—	—	566	△ 0	566
2013年3月31日 期末残高	8,932	462	6,890	△ 8	16,276

	その他の包括利益累計額			少数株主持分	純資産合計
	その他有価証券評価差額金	為替換算調整勘定	その他の包括利益累計額合計		
2012年4月1日 期首残高	497	△ 281	215	—	15,926
連結会計年度中の変動額					
剰余金の配当					△ 125
当期純利益					691
自己株式の取得					△ 0
株主資本以外の項目の連結会計年度中の変動額(純額)	△ 105	484	379	200	579
連結会計年度中の変動額合計	△ 105	484	379	200	1,145
2013年3月31日 期末残高	392	202	595	200	17,072

## 会社の概要

商号	TOWA株式会社 (英文名TOWA CORPORATION)		
設立	1979年4月17日		
資本金	8,932,627,777円		
本社所在地	京都市南区上鳥羽上調子町5番地 ☎(075) 692-0250(代表)		
従業員数	425名		
役員 (2013年6月27日現在)	代表取締役会長	坂東和彦	
	代表取締役社長	岡田博和	
	専務取締役	天川剛	
	常務取締役	小西久二	
	常務取締役	福富誠	
	取締役執行役員	浦上浩	
	取締役	田村吉住	
	取締役	桑木肇	
	執行役員	石田耕一	
	執行役員	岸本昌利	
	執行役員	中村尚	
	常勤監査役	小林久芳	
	監査役	杉山律	
	監査役	和氣大輔	
ホームページ	<a href="http://www.towajapan.co.jp">http://www.towajapan.co.jp</a>		
上場取引所	東京証券取引所市場第一部 大阪証券取引所市場第一部		

## 株主メモ

事業年度	毎年4月1日から翌年3月31日までの1年		
定時株主総会	毎年6月		
基準日	株主総会権利行使および期末配当 3月31日 中間配当 9月30日		
単元株式数	100株		
株主名簿管理人	東京都中央区八重洲一丁目2番1号 みずほ信託銀行株式会社		
同事務取扱場所	大阪市北区曽根崎二丁目11番16号 みずほ信託銀行株式会社大阪支店証券代行部		
郵便物の郵送先及び 電話お問合せ先	〒168-8507 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 みずほ信託銀行株式会社証券代行部 ☎0120-288-324(フリーダイヤル)		
未払配当金のお支払	みずほ信託銀行 本店および全国各支店 みずほ銀行 本店および全国各支店 (みずほ証券では取次のみとなります)		
公告方法	電子公告の方法により行います。但し、 やむをえない事由により電子公告を することができない場合は、日本経済新聞 に掲載します。 公告掲載URL <a href="http://www.towajapan.co.jp">http://www.towajapan.co.jp</a>		

## 株式の状況 (2013年3月31日現在)

●発行可能株式総数	80,000,000株
●発行済株式の総数	25,021,832株
●株主数	8,778名
●大株主	

株主名	持株数	持株比率
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社	3,728千株	14.91%
有限会社ケイビー恒産	2,000	8.00
坂東和彦	1,555	6.22
日本マスタートラスト信託銀行株式会社	1,409	5.64
野村信託銀行株式会社	733	2.93
株式会社京都銀行	699	2.80
有限会社ケイビーテクノ	500	2.00
山田矩規子	490	1.96
資産管理サービス信託銀行株式会社	338	1.35
坂東敬子	320	1.28

(注1) 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社、日本マスタートラスト信託銀行株式会社、野村信託銀行株式会社および資産管理サービス信託銀行株式会社の所有株式数は信託業務に係るものです。

(注2) 持株比率は、自己株式(9,923株)を控除して計算しております。

## TOWAグループ (2013年3月31日現在)

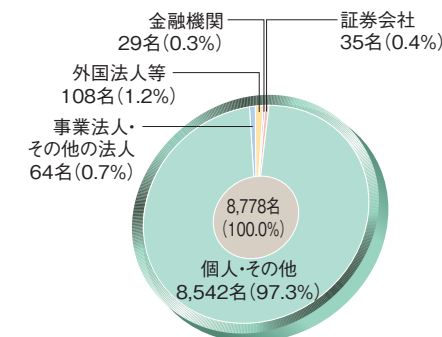
### 国内

TOWA株式会社  
本社・工場  
京都東事業所  
坂東記念研究所  
九州事業所  
東京営業所  
株式会社バンディック  
TOWATEC株式会社  
株式会社サーク

### 海外

TOWA Asia - Pacific Pte. Ltd. (シンガポール)  
TOWAM Sdn. Bhd. (マレーシア)  
TOWA Semiconductor Equipment  
Philippines Corporation (フィリピン)  
TOWA USA Corporation (米国)  
TOWA Europe GmbH (ドイツ)  
東和半導体設備(上海)有限公司 (中国)  
上海沙迪克軟件有限公司 (中国)  
TOWA半導体設備(蘇州)有限公司 (中国)  
蘇州STK鑄造有限公司 (中国)  
台湾東和半導体設備股份有限公司 (台湾)  
巨東精技股份有限公司 (台湾)  
株式会社東進 (韓国)

### 所有者別株主数分布



### 所有者別株式数分布

